

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年8月31日(2006.8.31)

【公開番号】特開2001-35970(P2001-35970A)

【公開日】平成13年2月9日(2001.2.9)

【出願番号】特願平11-203536

【国際特許分類】

H 01 L 23/28 (2006.01)

H 01 L 23/12 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/28 H

H 01 L 23/28 Z

H 01 L 23/12 L

【手続補正書】

【提出日】平成18年7月13日(2006.7.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

また、識別記号Mは、分離された半導体チップ1が半導体基板10内のどこに位置していたものな~~か~~を特定するための第2識別部M2を含んで~~い~~いるので、複数個の半導体チップ1とパッケージベース2とに分離して個々の半導体装置A1を形成した後においても、対象とする半導体装置A1の半導体チップ1が、半導体基板10内においてどこに位置していたものな~~か~~が容易に特定することができ、半導体チップ1あるいは半導体基板10の不良品解析等を短時間で且つ容易に行うことも可能となる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0040

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0040】

パッケージベース2の角部(4箇所)には、貫通孔26を横断して半導体基板10とパッケージ基板20とを一体的に切断したので、個々の半導体装置A2に分離した際に、貫通孔26の一部がパッケージベース2の角部を切り欠いた状態の凹部3として残り、この凹部3が位置決め用の位置決め部として用いられる。また、パッケージベース2の他方の面2a(半導体チップ1に対向する面の裏面)には、受光部14に対応する位置Dの外側部分の裏面側の位置で、且つ、矩形に形成されるパッケージベース2の辺部近傍となる位置に識別記号Mが付与されている。識別記号Mは、半導体装置A2を外部基板(図示せず)に搭載する際の、半導体装置A2の向きを特定するために用いられ、識別記号Mに基づいて、半導体装置A2を適切な向きに設定した上で、凹部3に対して外部基板側に設けられるガイドピン(図示せず)を立てて半導体装置A2の位置合わせを行う。